# 石巻工場 Feature ①

### 半導体パッケージの技術課題にソリューションを提供する工場

#### 信号高速化

- インピーダンス整合精度向上
- 信号配線細線化対応

#### メイコーストロングポイント!

- 石巻工場では、(サブトラ・SAP・ MSAP) に対応。
- 高精度のパターン形成技術による 信号品質向上。

SI

シグナル インテグリティ

高集積化・マルチチップ化 による部品発熱対策

# 高密度化による

電源供給強化・安定化

#### メイコーストロングポイント!

- 部品内蔵技術を組合せ対応。(受動部品・パッシブ部品実績あり)
- コア層の多層化 (電源層強化)
- 厚銅の積層 (70 µ m箔)

### PI

パワー インテグリティ

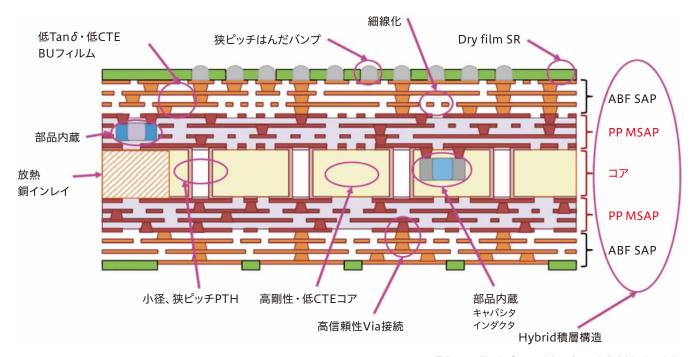
## Thermal

サーマル マネジメント

#### メイコーストロングポイント!

- 各種放熱基板プロセス
- 熱シミュレーション対応可
- 高耐熱材、低CTE材

### 新規構造の提案



※備考:図は様々なプロセスを組み合わせた参考例になります。

メイコー保有プロセスで上記基板構造の実現が可能です

